



平成23年2月14日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード: 3156 東証第一部)
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先: 取締役 経理部門、財務部担当 田口 雅章
(TEL: 03-3491-6575)

子会社の事業譲渡に係る基本合意の締結に関するお知らせ

当社及び当社連結子会社(所有割合70.3%)である株式会社ユニーデバイス(以下、ユニーデバイスという)は、平成23年2月14日開催の取締役会において、ユニーデバイスの事業を、丸文株式会社(以下、丸文という)の100%子会社である丸文セミコン株式会社(以下、丸文セミコンという)へ譲渡することに関する基本合意書を締結する旨決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本事業譲渡は、ユニーデバイスの株主総会により承認が得られることを条件に実施されるものであります。

記

1. 事業譲渡の背景・理由

ユニーデバイスは、サムスン電子製半導体・電子部品の販売事業を行う当社連結子会社であります。昨年末以来、当社及びユニーデバイスは、丸文及びユニーデバイスと同業を営む丸文セミコンと同事業の統合とその形態について検討を進めておりました。

一方、当社は、本日公表いたしました「EMS(電子機器受託製造サービス)事業の拡大に関するお知らせ」にあるとおり、中国におけるEMS事業に追加投資を行うことといたしました。

このような状況を踏まえ様々な選択肢を検討した結果、当社グループの事業の方向性に鑑み、当社及びユニーデバイスは、ユニーデバイスの事業を丸文セミコンに譲渡することに関する基本合意書を締結する旨決議いたしました。今後は、高級デジタルスチルカメラ、携帯電話、及び市場の急拡大が見込まれるスマートフォン向けを中心にソニー製半導体・電子部品の販売をさらに強化するとともに、EMS等の高付加価値事業を強化し、業績の拡大を図ってまいります。

なお、当社グループの販売先であるサムスングループとは、従来の半導体・電子部品の販売に加えて、EMS事業を推進することで引き続き良好な関係を維持し、取引を拡大していく所存です。

2. 事業譲渡の内容

(1) 事業譲渡会社の概要

(a) 商号	株式会社ユニーデバイス
(b) 設立年月日	平成8年7月1日
(c) 所在地	東京都品川区西五反田7丁目10番4号
(d) 代表者	代表取締役社長 稲葉 隆志
(e) 事業内容	サムスン電子製半導体・TFT液晶等の輸出入、販売、技術サポート
(f) 資本金	334百万円
(g) 決算期	3月末日
(h) 大株主(持株比率)	当社(70.3%)、日本サムスン株式会社(14.1%)
(i) 子会社	上海:UNI DEVICE (SHANGHAI) CO., LTD. シンガポール:UNI DEVICE (S) PTE. LTD.

(2) 譲渡事業の内容

サムスン電子製半導体・電子部品の販売事業

(3) 対象事業の経営成績(平成22年3月期)

(百万円)

	対象事業 実績 ^{※1} (a)	当社 連結実績 ^{※2} (b)	比率(a/b)	当社 連結実績(参考) ^{※3}
売上高	49,946	215,162	23.2%	253,996
売上総利益	1,353	11,556	11.7%	14,998
営業利益	149	2,734	5.5%	3,023
経常利益	230	2,259	10.2%	2,294
当期純利益	154	6,094	2.5%	6,058

※1 ユニーデバイスとその海外子会社2社を連結した経営成績を記載しています。

※2 当社連結実績について

当社は、平成21年10月1日付で株式会社ユーエスシー(以下、ユーエスシーという)と共信テクノソニック株式会社(以下、共信テクノソニックという)との経営統合に伴い、両社の共同持株会社として設立されました。設立に際し、ユーエスシーを取得企業として企業結合会計を行っているため、平成22年3月期の連結経営成績は、取得企業であるユーエスシーの連結経営成績を基礎に、共信テクノソニックの下期(平成21年10月1日から平成22年3月31日まで)の連結経営成績を連結したものととなります。また、当期純利益は、主として、経営統合によって生じた負ののれん相当額51億80百万円を一括して「負ののれん発生益」として特別利益に、本社等の移転や事業の統廃合に伴う一時費用を特別損失にそれぞれ計上したことによるものです。

※3 当社連結実績(参考)

※2の当社連結実績に、共信テクノソニックの上期(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の連結経営成績を単純合算したものです。

(4) 譲渡資産、負債の項目及び金額

事業譲渡日におけるたな卸し資産を譲渡し、その他細目については今後協議の上確定させます。また、ユニーデバイスの役員、従業員は丸文セミコンに移籍する予定です。

(5) 譲渡価額及び決済方法

譲渡価額及び決済方法については、現在確定しておりません。

3. 事業譲渡の日程

平成 23 年 2 月 14 日	基本合意書締結
平成 23 年 3 月中旬	取締役会決議 (ユニーデバイス) (予定)
平成 23 年 3 月中旬	事業譲渡契約締結 (ユニーデバイス) (予定)
平成 23 年 3 月下旬	事業譲渡承認株主総会 (ユニーデバイス) (予定)
平成 23 年 6 月 1 日	事業譲渡実行 (予定)

4. 事業の譲渡先の概要

(a) 商号	丸文セミコン株式会社	
(b) 所在地	東京都港区芝 2 丁目 1 番 28 号	
(c) 代表者	代表取締役社長 相原 修二	
(d) 事業内容	半導体・液晶パネルおよび関連部品機器等の設計、製造、サービス、国内販売、輸出入	
(e) 資本金	301 百万円	
(f) 設立年月日	平成 17 年 3 月 1 日	
(g) 純資産	1,017 百万円 (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(h) 総資産	17,038 百万円 (平成 22 年 3 月 31 日現在)	
(i) 大株主 (持株比率)	丸文株式会社 (100%)	
(j) 当社との関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

5. 会計処理の概要

会計処理については、まだ確定しておりません。

6. 今後の見通し

今後は事業譲渡契約締結に向けて当事者間で協議を進めてまいります。

本件が、当社の平成 23 年 3 月期及び平成 24 年 3 月期の連結業績に与える影響、その他詳細につきましては、事業譲渡の正式契約締結後、明らかになり次第、別途公表いたします。

以上